



統懋半導體股份有限公司

資金貸與他人作業程序

第一條：訂定目的及法令依據

本公司辦理資金貸與他人，悉依本程序之規定辦理。

本程序依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定，但金融相關法令另有規定者，從其規定。

第二條：資金貸與之對象

一、公開發行公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：

本公司直接及或間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司。

二、所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。

三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或公開發行公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對該公開發行公司從事資金貸與，不受融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十之限制。但仍應訂定資金貸與總額及個別對象之限額，並應明定資金貸與期限。

四、公司負責人違反第一項及前項但書規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。

五、本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

六、本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本準則所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

第三條：資金貸與他人之原因及必要性

本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司，因償還銀行借款、購置設備及營業週轉需要而有短期融通資金之必要者。

第四條：資金貸與總額及單一對象之限額

一、資金貸與總額：本公司淨值之百分之四十。

二、單一對象限額：本公司淨值之百分之四十。

本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與不



統懋半導體股份有限公司

資金貸與他人作業程序

受第二條第一項第二款及第四條第一項第一款及第二款之限制，但仍應依第四條及第五條規定訂定資金貸與之限額及期限。

第五條： 資金貸與之期限及利息

- 一、每筆資金貸與期限以一年以下為原則，並可分期收回。
- 二、資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況予以調整。

第六條： 資金貸與之辦理程序

- 一、經本公司權責單位審查後，呈董事長核准並提報董事會決議通過後辦理之。本公司與子公司間或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。前項所稱一定額度，除符合第四條第二項規定者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。
- 二、財務部門應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本條規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。
- 三、內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。
- 四、財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，俾控制追蹤及辦理公告申報，並應按季評估及提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
- 五、因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計劃送審計委員會，依計畫於改善後，報告於董事會。

第七條： 資金貸與之審查程序

- 一、本公司辦理資金貸與時由財務部門先詳細審查：
 1. 資金貸與他人之必要性及合理性。
 2. 貸與對象之徵信及風險評估。
 3. 對公司之營運風險，財務狀況及股東權益之影響。
 4. 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。



統懋半導體股份有限公司

資金貸與他人作業程序

二、本公司辦理資金貸與時，應由財務部門提報簽呈，就融資對象之所營事、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途等予以調查、評估，並擬訂貸與最高金額、期限及計息方式之報告書呈請總經理、董事長核決後送交董事會決議。

三、應由融資對象提供相當融資額度之擔保品，並保證其權利之完整。以公司為保證者，該保證公司應在公司章程中訂定有得為保證之條款。

第八條： 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

一、貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變動，遇有重大變化時，應立刻通報總經理及相關權責單位儘速處理。

二、借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

三、借款人於貸款到期時，應即還清本息，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第九條： 公告申報程序

一、本程序所稱之公告申報，係指輸入主管機關指定之資訊申報網站。

二、本程序所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。

三、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與額。

四、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：

1.本公司及子公司資金貸與之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

2.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。

3.本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

五、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，子公司有前項第三款應公告申報之事項，由本公司為之。



統懋半導體股份有限公司

資金貸與他人作業程序

第十條： 對子公司資金貸與之控管程序

- 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人者，應命其先訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。
- 二、本公司對被投資達五十%以上之子公司若因營運需要，擬將資金貸與他人金額達新台幣伍佰萬元以上者，應依本程序第七條作成報告書後，送交本公司董事會決議。

第十一條： 經理人及主辦人員違反本程序時之處罰

本公司經理人及主辦人員違反本程序時，依公司規章相關規定處罰。

第十二條： 其他事項

本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，提董事會決議通過後，並提報股東會同意後實施，修訂時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將董事異議資料送審計委員會。且應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留意見於董事會議事錄載明。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條： 訂定於民國八十六年一月三十一日

- 第一次修訂於民國九十二年六月二十六日
- 第二次修訂於民國九十六年六月二十九日
- 第三次修訂於民國九十八年一月二十三日
- 第四次修訂於民國九十八年六月十九日
- 第五次修訂於民國九十九年六月二十三日
- 第六次修訂於民國一〇二年六月二十八日
- 第七次修訂於民國一〇九年六月二十九日
- 第八次修訂於民國一一〇年七月七日



統懋半導體股份有限公司

背書保證作業程序

第一條之一：
法令依據

本程序依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定，但金融相關法令另有規定者，從其規定。

第二條：適用範圍：

一、本作業程序所稱之背書保證包括：

1. 融資背書保證：
2. 客票貼現融資。
3. 為他公司融資之目的所為之背書或保證。

二、為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

三、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。

公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本準則規定辦理。

第三條：背書保證之對象：

本公司背書保證之對象，以下列公司為限：本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司。

本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之公司間，得為背書保證。

本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。

第四條：背書保證額度

一、本公司對外背書保證之總額以本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限，本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司最近期財務報表淨值百分之三十為限。

二、本公司對單一企業之背書保證金額以最近期財務報表淨值百分



統懋半導體股份有限公司

背書保證作業程序

之十為限，本公司及子公司整體對單一企業背書保證之總額以本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限。公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，其金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

第五條： 背書保證辦理及審查程序：

一、本公司辦理背書保證時，應由財務部門審查：

- 1.背書保證之必要性及合理性。
- 2.背書保證對象之徵信及風險評估。
- 3.對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
- 4.應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

二、本公司辦理背書保證時，應由財務部門提報簽呈，敘明承諾擔保事項、被背書保證公司名稱、金額及解除背書保證責任之條件及日期等，呈請董事長、總經理核決後在送交董事會決議。

三、本公司辦理背書保證事項，財務部門應建立備查簿就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依第一項規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。

四、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。

第六條： 對子公司辦理背書保證之控管程序

一、本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，應命其訂定背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。

二、本公司之子公司擬為他人背書保證前，應依本程序第五條第二項作成報告書後，送交本公司董事會決議。

第七條： 印鑑章保管及程序：

一、本公司以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章，由董事會授權董事長指派專人保管，印章保管人變更時應報經董事會同意，並將所保管之印鑑列入移交。

二、背書保證事項經董事會決議通過或董事長、總經理核決後，由財務單位填寫用印申請書，連同核准紀錄及背書保證契約書或



統懋半導體股份有限公司 背書保證作業程序

保證票據等用印文件，經財務主管核准後，始得至印鑑保管人處用印或簽發票據。

- 三、印鑑保管人用印時，應核對有無核准紀錄，並查對用印文件是否與申請事項相符，確認無誤後，始得用印。
- 四、公司所屬之子公司若設立於國外，則上述有關向經濟部申請登記之公司印章為背書保證專用印鑑，改採當地登記之公司印章或簽名為背書保證專用印鑑或簽名。
- 五、本公司對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函，由董事會授權董事長或總經理簽署。

第八條： 決策及授權層級：

- 一、本公司辦理背書保證時，應依本作業相關程序簽核，並經董事會同意後為之，但為配合時效，在背書保證總額及單一企業金額不超過本作業程序所訂定之額度內，由董事會授權董事長依背書保證對象之信用程度及財務狀況逕行核決，再報最近期之董事會追認。
- 二、本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本作業程序所訂背書保證額度之必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，應經董事會同意，並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。
- 三、本公司因情事變更，致背書保證對象不符本準則規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送審計委員會，依計畫改善後，報告於董事會。

第九條： 公告申報程序

- 一、本程序所稱之公告申報，係指輸入主管機關指定之資訊申報網站。
- 二、本程序所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等日期孰前者。
- 三、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保



統懋半導體股份有限公司 背書保證作業程序

證餘額。

四、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：

- 1.本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。
- 2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
- 3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
- 4.本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

五、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。

第十條： 罰則：

本公司經理人及主辦人員違反本程序時依公司規章相關規定處罰。

第十一條： 財務報表之揭露

本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

第十二條： 其他事項

本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，提董事會決議通過後，並提報股東會同意後實施，修訂時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將董事異議資料送審計委員會。且應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留意見於董事會議事錄載明。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。



統懋半導體股份有限公司 背書保證作業程序

第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

- 第十三條：
- 訂定於民國八十六年一月三十一日
 - 第一次修訂於民國九十二年六月二十六日
 - 第二次修訂於民國九十六年六月二十九日
 - 第三次修訂於民國九十八年一月二十三日
 - 第四次修訂於民國九十八年六月十九日
 - 第五次修訂於民國九十九年六月二十三日
 - 第六次修訂於民國一〇〇年六月二十八日
 - 第七次修訂於民國一〇二年六月二十八日
 - 第八次修訂於民國一〇六年六月二十八日
 - 第九次修訂於民國一〇九年六月二十九日
 - 第十次修訂於民國一一〇年七月七日